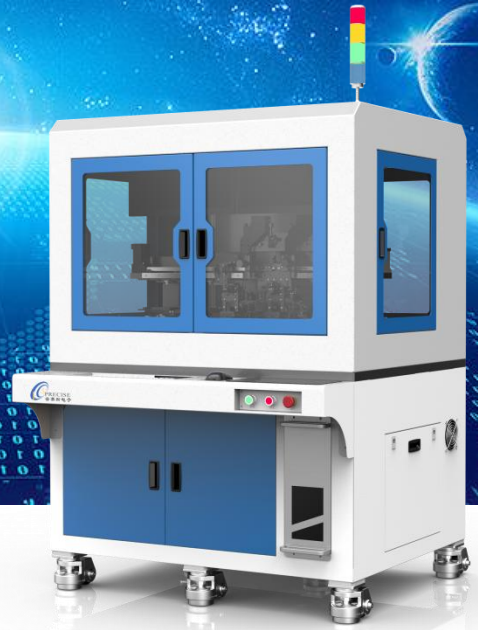


# PSS CHIP 机系列

## CHIP 自动测试系统 ▶▶▶

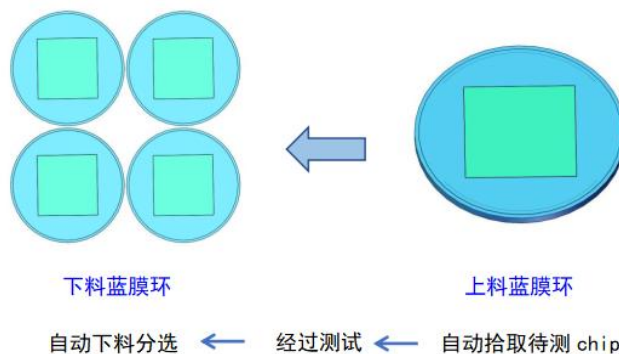


## 产品简介

本设备应用于光芯片 LD-CHIP 高温/常温 LIV 测试、SMSR 测试及背光抽测并对不同测试结果进行归类分档筛选。芯片 wafer 蓝膜上料，CHIP-ID 自动识别记忆匹配测试，通过蓝膜顶针剥离机构，吸嘴吸取，机械手分别搬运到高温及常温测试区域，自动摆位，自动测试，分析筛选，机械手搬运分档归类。此设备具有高速、高精度特点，实现了复杂时序、严密逻辑的工艺流程。设备采用了偏心凸轮驱动、连杆及精密夹具等机构，配合多轴运动、视觉定位、视觉字符匹配等技术，具有批量生产能力。

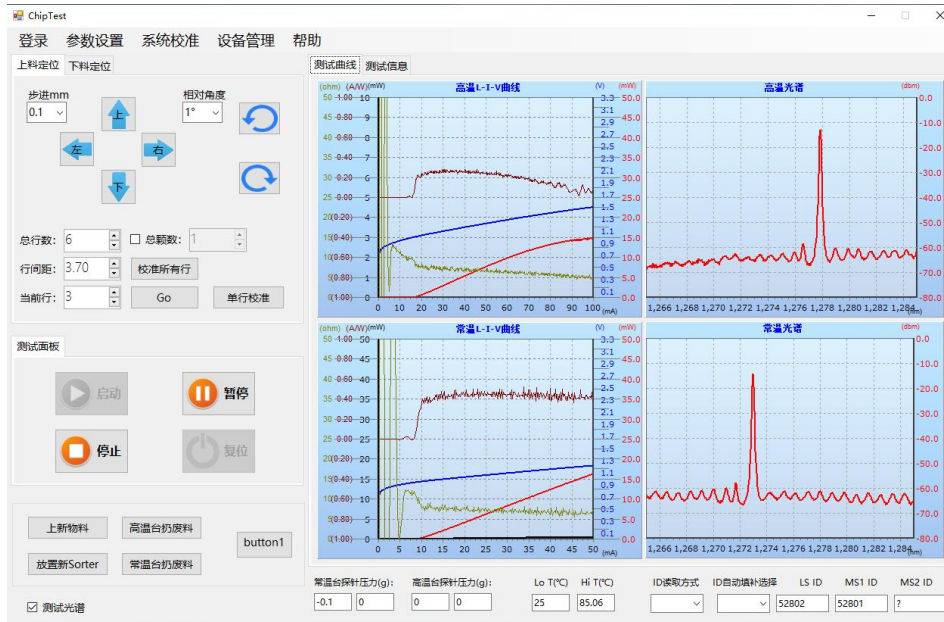
## 产品应用

- 设备用于裸 chip 自动测试分 bin，可以实现常温、高温条件下边发射芯片的光谱、LIV 参数测试

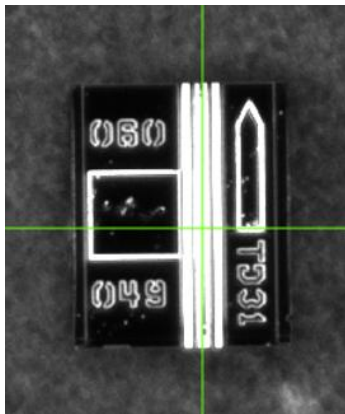


## 产品特点

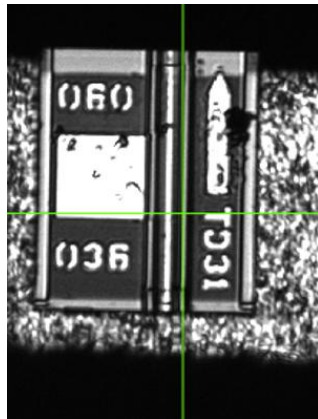
- 支持 Chip 的 LIV、光谱相关参数的测试、绘制测试曲线



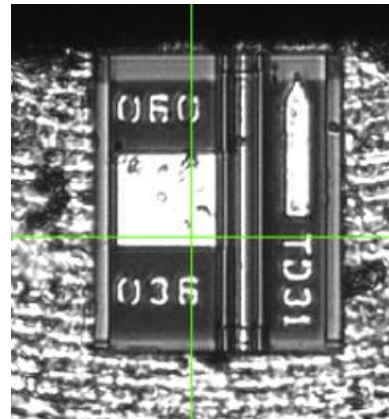
- 芯片蓝膜自动上料, 通过视觉系统自动识别芯片 ID, 测试台支持芯片在相机下自动二次定位, 精准控制探针加电测试



上料相机对焦



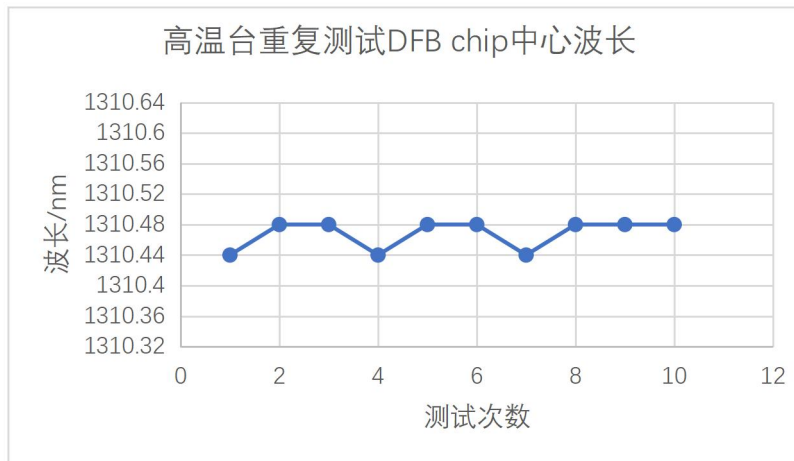
常温台相机对焦



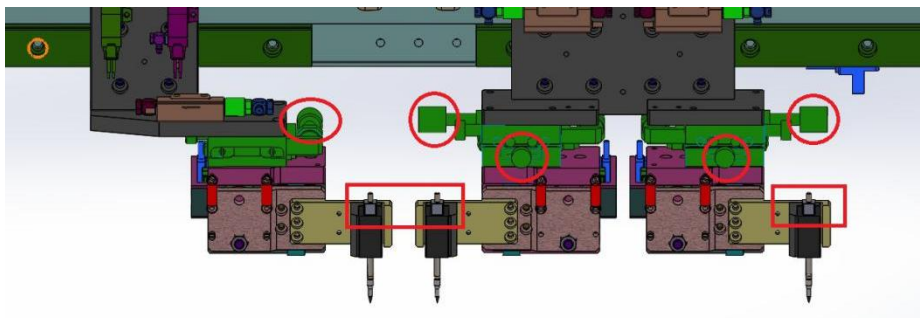
高温台相机对焦

- 探针自动下压加电, 探针下压力度可调, 支持探针力度实时显示

- 高温、常温测试台，温度采用闭环控制



- 上料和中转动作同步，常温、高温载台测试并行，提升测试效率,上料吸嘴采用自重下压力，对 chip 无损伤



- 支持测试台位光谱仪一拖二，节省系统测试成本
- 生产过程中的异常情况均有报警提示及纠错提示功能
- 与 BAR 条接触的材料采用防静电材料，并接地处理，配有静电消除离子风机
- 支持本地和远程数据库
- 多维度可调测量结构，满足用户对不同规格 chip 测量需求
- 可用标准 TO 及芯片进行校准，并对其他工艺参数进行设置
- 针对生产过程中的重要环节均有实时动态提示
- 与芯片接触的材料采用防静电材料，并接地处理；上料处配有静电消除离子风机
- 软件支持本地和远程数据库

## ■ 技术参数

参 数	指 标
适合芯片尺寸	芯片长度 200-300 $\mu\text{m}$ ; 芯片宽度 150-300 $\mu\text{m}$ 其他尺寸可定制测试载台
供料尺寸	6 寸蓝膜环, 下料区有 4 个蓝膜环放置位, 具备自动分 bin 功能
测试载台	常温/高温测试台, 实现上料、位置校准与测试并行
测量参数	LIV 曲线, Ith, Po, Vf, Im, Rs, SE, Kink, 光谱参数等
LD 驱动电流	范围 0-250mA, 最大可定制到 500mA, 支持脉冲输出
正向电压测试	范围 0-5V
光功率测试	测试范围 0-30mW; 波长范围 900-1700nm (以光谱仪为准)
温度控制	常温 18-40 $^{\circ}\text{C}$ ; 高温 40-90 $^{\circ}\text{C}$ ; 稳定性 $\leq \pm 0.1^{\circ}\text{C}$
测试效率 (典型值)	单颗 $\leq 6\text{s}$ (单光谱点测试, AQ6360D)
电源	AC 220V/32A 50Hz